

Title (en)

Process for making a resiliently-mounted floor and support therefor

Title (de)

Verfahren zur Herstellung eines schwingungsfähigen Fussbodens und Stütze hierfür

Title (fr)

Procédé de fabrication d'un plancher monté élastiquement et appui à cet effet

Publication

EP 0835969 A2 19980415 (DE)

Application

EP 97117293 A 19971007

Priority

DE 19641812 A 19961010

Abstract (en)

The support base (12) for the sprung floor is fitted with hollow elastic supports (14) open to the top. An elastic compound is poured into the supports and the floor plates (30) are placed over the supports before the compound sets. After setting the compound adheres to the underside of the plates and provides an elastic support in both directions. A top floor covering (32) completes the structure. The floor plates are fitted with threaded spacers (42) to set the level of the floor above the base and to ensure a flat floor. The spacers are removed after the compound has set. The hollow supports are secured to the base floor with threaded fasteners, e.g. bolt(22), clamping flange (18). The elastic compound also bonds over the fastening. The top covering is laid to overlap the joins in the floor plates.

Abstract (de)

Das Verfahren dient zum Aufbau eines schwingungsfähigen Fußbodens (10) auf einem festen Unterbau (12) unter Verwendung plattenförmiger Elemente (30). Schwingungsfähige Fußböden sind aufgrund ihres komplizierten Aufbaues teuer in der Herstellung. Um sie einfacher und mit geringerem Materialaufwand aufbauen zu können, wird vorgesehen, daß hohle, höhenveränderliche Elemente (14) auf dem Unterbau (12) befestigt werden, die mit einem elastisch aushärtenden, in fließfähigem Zustand adhäsiven Material (16) gefüllt werden, und vor dem Aushärten Grundplatten (30) auf die befüllten Elemente (14) aufgelegt und ausgerichtet werden, wobei die Grundplatten (30) beim Anheben darunterliegende Elemente (14) infolge der Adhäsion des Füllmaterials (16) mitnehmen. Nach dem Aushärten wird auf den Grundplatten (30) wenigstens eine weitere Bodenschicht (32) aufgebracht. Dieses Verfahren läßt sich schnell und mit sehr einfachen Mitteln durchführen. <IMAGE>

IPC 1-7

E04F 15/22

IPC 8 full level

E04F 15/22 (2006.01)

CPC (source: EP US)

E04F 15/02488 (2013.01 - EP US); **E04F 15/22** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN102316770A; US11834848B2; US9192850B2; WO2021080225A3; WO2011042385A3; WO2010092519A3; WO2010092519A2; US9986863B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL PT

DOCDB simple family (publication)

EP 0835969 A2 19980415; **EP 0835969 A3 20000823**; **EP 0835969 B1 20040922**; AT E277248 T1 20041015; DE 19641812 A1 19980423; DE 19641812 B4 20041111; DE 59711940 D1 20041028; ES 2229306 T3 20050416; PT 835969 E 20050228; US 6070381 A 20000606

DOCDB simple family (application)

EP 97117293 A 19971007; AT 97117293 T 19971007; DE 19641812 A 19961010; DE 59711940 T 19971007; ES 97117293 T 19971007; PT 97117293 T 19971007; US 94825797 A 19971009